ITI Electronic Mechanic 2nd Year Module 3 Basic SMD 1

(1). Which is alternative to ceramic SMD IC packages? | सिरेमिक SMD IC पैकेज का विकल्प क्या है?

(A) Glass packages | ग्लास पैकेज

(B) Plastic packages | प्लास्टिक के पैकेज

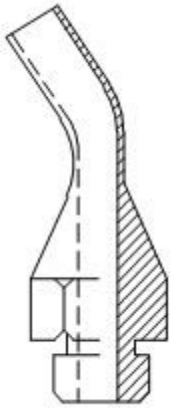
(C) Metal packages | धातु पैकेज

(D) Fiber packages | फाइबर पैकेज

Correct Answer : B

amyt.net

(2). Which type of hot air pencil tip is used in SMD soldering? | SMD सोल्डरिंग में किस प्रकार की गर्म हवा पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है?



(A) Oval type | ओवल टाइप

(B) Round type | राउंड टाइप

(C) Angled type | एंगल्ड टाइप

(D) Fine / jet type | फाइन / जेट टाइप

Correct Answer : C

(3). What is the range of temperature setting on soldering work station for soldering SMD ICs? | सोल्डरिंग SMD ICs के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या है?

(A) 100°C to 200°C

(B) 200°C to 250°C

(C) 250°C to 280°C

(D) 280°C to 400°C

Correct Answer : C

(4). What is the name of the defect caused due to ESD event? | ESD घटना के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है?

(A) Mechanical defect | यांत्रिक दोष

(B) Dripping defect | ढकेलने का दोष

(C) Latent defect | अप्रकट दोष

(D) Tombstone defect | टोम्बस्टन दोष

Correct Answer : C

www.itiexamyt.net

(5). What is the use of Bench top Ionisers? | बेंच शीर्ष Ionisers का उपयोग क्या है?

(A) To control moisture in atmosphere | वातावरण में नमी को नियंत्रित करने के लिए

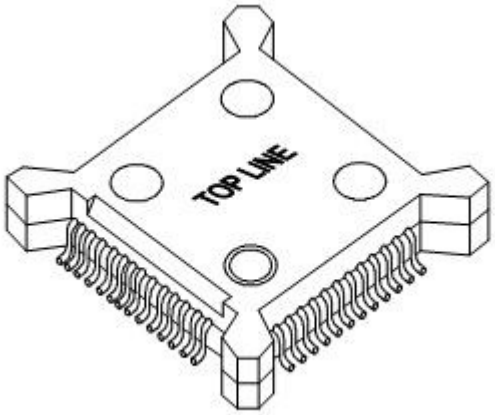
(B) To control ESD in work environment | काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए

(C) To control voltage | वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए

(D) To eliminate molecules | अणुओं को कम करने के लिए

Correct Answer : B

(6). What is the name of the IC package? | IC पैकेज का नाम क्या है?



(A) CQFP

(B) PQFP

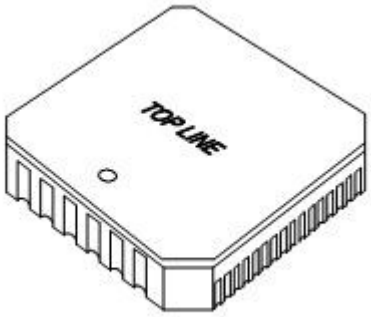
(C) BQFP

(D) LQFP

Correct Answer : C

www.itiexamyt.net

(7). What is the type of SMD IC package? | SMD IC पैकेज के प्रकार क्या है?



(A) LCC

(B) PLCC

(C) MLCC

(D) TSOP

Correct Answer : A

(8). Which SMD IC needs lead forming equipment to cut and bent into gull wing type? | कौन सी SMD IC को गूल विंग प्रकार में कटौती और झुकाने के लिए सीसा बनाने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है?

(A) TSOP

(B) FLAT Package | फ्लैट पैकेज

(C) Pin grid array | पिन ग्रिड ऐरे

(D) Leaded chip carrier | लीडेड चिप कर्रिएर

Correct Answer : B

(9). Which technology is used to place the components directly on the printed circuit boards? | मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?

(A) Solder Mount Technology | सोल्डर माउंट प्रौद्योगिकी

(B) Surface Mount Technology | भूतल माउंट प्रौद्योगिकी

(C) Safety Metaphor Technology | सुरक्षा रूपक प्रौद्योगिकी

(D) Silicon multiplayer Technology | सिलिकॉन मल्टीप्लेयर प्रौद्योगिकी

Correct Answer : B

(10). What is the power rating of soldering iron used in electrical and electronics work? | इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उपयोग किए जाने वाले टांका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन की शक्ति रेटिंग क्या है?

(A) 15 to 35 watts | 15 से 35 watts

www.itiexamyt.net

(B) 40 to 65 watts | 40 से 65 watts

(C) 75 to 100 watts | 75 से 100 watts

(D) 85 to 135 watts | 85 से 135 watts

Correct Answer : A

(11). Which method is effective to control ESD, during manufacturing the devices? | उपकरणों के निर्माण के दौरान ESD को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है?

(A) Use helmet | हेलमेट का उपयोग करें

(B) Use metal chain | धातु चेन का उपयोग करें

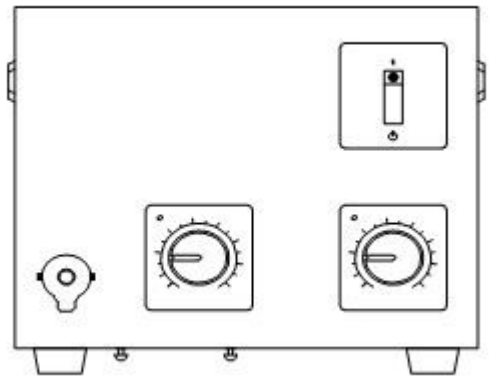
(C) Use ESD wrist strap | ESD कलाई का पट्टा का उपयोग करें

(D) Use tables | टेबल्स का उपयोग करें

Correct Answer : C

vitiexamyt.net

(12). What is the name of the device? | डिवाइस का नाम क्या है?



(A) Microcontroller | माइक्रो कंट्रोलर

(B) Signal generator | संकेत उत्पादक यन्त्र

(C) SMD workstation | SMD कार्य केंद्र

(D) Insulation tester | इन्सुलेशन परीक्षक

Correct Answer : C

(13). What is the purpose of bumpered corners of Bumper Quad Flat Pack? | बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है?

(A) Prevent Vibration | कंपन को रोकें

(B) Dissipate heat | उष्मा नष्ट करना

(C) Protects the IC leads | IC लीड की रक्षा करता है

(D) Gives mechanical strength | यांत्रिक शक्ति देता है

Correct Answer : C

(14). How does the desoldering braid removes the molten solder from the joint on the PCB? | डीसोल्डरिंग ब्रैड PCB पर जोड़ से पिघला हुआ फ्लक्स कैसे निकालता है?

(A) By capillary action | केशिका क्रिया द्वारा

(B) By heating the joint | जोड़ को गर्म करके

(C) By hardening the solder | सोल्डर को सख्त करके

(D) By increasing the temperature | तापमान में वृद्धि करके

Correct Answer : A

(15). What is the full form of SOIC? | SOIC का पूर्ण रूप क्या है?

(A) Surface Optimized Internal Circuits | Surface Optimised Internal Circuits

(B) Small Outline Integrated Circuits

(C) Service Outline Internal Circuits

(D) Solder Oriented Integrated Circuits

www.rrbexamyt.net

Correct Answer : B

(16). What is called 'tinning' in soldering? | टांका लगाने में 'टिनिंग' क्या है?

(A) Clean the tip of the iron | लोहे की नोक को साफ करें

(B) Change the tip of the iron | लोहे की नोक को बदलें

(C) Melt a little solder on the tip of the iron | लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स पिघलाएं

(D) Remove the tip of the iron | लोहे की नोक को हटा दें

Correct Answer : C

(17). What is the name of SMD tool? | SMD उपकरण का नाम क्या है?

(A) 90° forming tool | 90° बनाने का उपकरण

(B) Monocle magnifier | मोनोकोल आवर्धक

(C) Heated tweezers | गरम चिमटी

(D) Soldering pumps | सोल्डरिंग पंप

Correct Answer : C

(18). What is the acceptable resistance value limit for the ESD wrist strap? | ESD रिस्ट स्ट्रेप के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है?

(A) 1Ω

(B) 1 KΩ

(C) 1MΩ

(D) 10MΩ

Correct Answer : C

(19). What is the full form of SMT? | SMT का फुल फॉर्म क्या है?

(A) Specific Multipin Technology

(B) Small Metalized Technology

(C) Surface Mount Technology

(D) Solder Mount Technology

Correct Answer : C

www.itiexamyt.net

(20). What is the full form of PGA used in SMD IC package? | SMD IC पैकेज में प्रयुक्त PGA का पूर्ण रूप क्या है?

(A) Package Grid Array

(B) Pin Grid Array

(C) Perfect Grid Array

(D) Popular Grid Array

Correct Answer : B